

## ■董事长专访

舜宇光学科技王钺炯：  
追光不止 硬核破局

◎记者 陈梦娜 柴刘斌

手机镜头、手机摄像模组、车载镜头、玻璃镜片，舜宇光学科技的四大产品销量均稳居全球第一。

当全球消费电子进入存量博弈的深水区，汽车行业需求快速升级，手握多项全球单品冠军的舜宇光学科技如何续写高速增长故事？这家光学巨头通过内部变革与战略重构，以“守正求变”之路，为发展注入新动能。

日前，舜宇光学科技董事长王钺炯在接受上海证券报记者专访时表示，公司始终深耕光学主业，加速向“制造商+智能光学系统方案（整机）解决商”和“产品价值+资本价值创造”转变。同时，公司还将抢抓 AI 视觉新蓝海，大力拓展 AI 可穿戴领域产品，并在 CPO（光共封装）上游领域布局。

甘当“配角”  
瞄准千亿元销售目标

坐落于浙江余姚智能光电小镇的舜宇光学科技，已然成为小镇发展的核心支柱。走进现代化新厂区，记者发现这里早已褪去当年乡镇企业的模样。

1984年，创始人王文鉴创办了舜宇光学科技，从无资金、无技术、无市场艰难起步，依靠为海康相机生产配套镜头，分得一杯羹。此后，公司采取横向联合策略，携手天津照相厂、江西光学仪器厂、杭州照相厂研究开展合作，相机镜头产能一度占到全国总量的九分之一。

2004年，舜宇光学科技提出了延续二十多年之久的“名配角战略”——做全球顶级客户的战略合作伙伴和首选零部件供应商，成为在产业链上具备核心竞争力的关键企业。凭借这一定位，2004年，舜宇大举切入手机镜头产业链，营收规模也水涨船高。

2025年，舜宇光学科技实现营收432.3亿元，同比增长12.9%；实现归属于股东的净利润46.4亿元，同比增长71.9%。从2004年到2025年，公司营收和净利润增长超过百倍。

在王钺炯看来，今天的舜宇，站在一个没有退路的历史关口。自己身上的责任更大了，担子更重了。

去年上任后，王钺炯没有急于烧“三把火”，而是花了近半年时间与各子公司高管深入交流。他敏锐地察觉到，随着公司规模扩大，原先分散在各子公司的职能部门已带来资源浪费与不平衡。

于是，一场深刻的内部变革悄然启动：聘请顶尖咨询公司全方位梳理，启动平台化建设，将装备、模具、资源等共性技术业务集中，充分整合各子公司力量，为接下来整个集团在“十五五”期间冲刺千亿元的销售目标制定路线图。

舜宇要做的不是安于现状，还要在新的产业周期里找对新的增长方向。王钺炯表示：“以前我们给客户类似镜头、模组的零部件产品，现在可以提供整套视觉感知系统，包括硬件整机、算法与解决方案等。”



舜宇光学科技余姚城西产业基地



王钺炯

“让舜宇发展得越来越好，是我和我父亲王文鉴的共同心愿。”王钺炯说。两代人共同的愿景为企业的代际传承奠定了坚实基础，也掀开了这家光学巨头的崭新篇章。

“硬核”镜头物理极限  
守牢光学“护城河”

手机光学与车载光学是舜宇光学科技的两大核心业务，占据公司营收的八成。

早年，公司曾涉足节能灯、消防器材等与主业关联不大的业务，均未取得理想成效。“我们深刻反思，必须回归主业。”王钺炯表示，目前公司业务均围绕光电领域展开，并逐渐向高附加值产品倾斜，高端化战略落地见效。

传统的长焦镜头，焦距越长模组越厚，与手机轻薄化需求严重背离。为了将复杂的长焦镜头塞入手机，舜宇光学科技投入技术攻坚团队，从镜头、马达到模组，反复打磨优化，形成一体化技术“护城河”，靠技术升级打开新的增长空间。

王钺炯认为，内存涨价对高端手机影响相对较小，消费者也更愿意为影像升级买单。因此，公司与国内外大客户在旗舰机型上进一步联合创新，通过提供一体化解决方案构筑技术壁垒，避免陷入低水平“内卷”，使得公司在行业下行周期中，仍有望实现手机业务的逆势增长。

汽车业务被舜宇光学科技视为确定性极高的增长极。公司在车载镜头领域连续十三年领跑，同时拥有安防镜头、红外光学等多项国家级单项冠军。

随着智能驾驶从L2向L3、L4级进阶，

对车载镜头的需求，不仅是数量的增加，也是性能和可靠性的全面升级。“L2级自动驾驶责任在驾驶员，到了L3级责任或将转移到车和方案商。这意味着摄像头一旦出问题，后果不堪设想。”王钺炯一语道破车载光学需求升级的核心逻辑。

舜宇光学科技抓住这一趋势，提前布局高像素、高信噪比的感知镜头，解决了镜头起雾、逆光眩光等行业痛点。“我们不参与低端的‘价格战’，始终坚持品质优先。当L3级以上的时代来临，我们的优势将会非常明显。”王钺炯称。

“公司会进一步深化与手机、车载、XR业务的海外大客户合作。特别是在手机业务上，今年海外大客户收入将实现增长100%以上。”王钺炯表示。

战略定力带来技术上的深厚积累。舜宇光学科技每年投入巨资进行研发，不仅在杭州成立了中央创新研究院，还先后在国内创新高地上海、西安、深圳、宁波及现代光学发源地欧洲等设立多元化的研究分支机构，并加快“走出去”步伐，加速越南等海外基地的建设。

舜宇在资本市场的动作渐趋频繁。2025年12月，舜宇光学科技完成与歌尔股份的换股事宜，旗下子公司持有歌尔光学31.31%股份，位列第二大股东，以增强其在光波导及其他晶圆级微纳光学器件领域的竞争力。

2026年1月，公司披露拟分拆车载光学业务于港交所独立上市，目前舜宇智行已正式递交。此外，还将单独成立舜宇资本，加大战略投资，聚焦Pre-IPO投资、基石投资和海外并购。

“舜宇要从生产世界上最优秀产品的企业，升级为一个孵化优秀企业的平台。”王钺炯表示，“在赋能产业链伙伴的同时，构建起共生共荣的产业链生态圈。”

布局新赛道  
长线卡位 AI 视觉

从存量中挖掘增量，并通过产学研布局

未来增量，成为舜宇光学科技当前战略的重中之重。王钺炯带领团队在多条赛道上同时发力，既有耐心广积粮，也有决心抢先机。

当前，AR眼镜普及的核心瓶颈是光波导等关键器件成本太高。“我们将用垂直整合逼近成本临界点，获取最大市场份额。”王钺炯说，“我们在智能手机的零部件领域证明了精密制造与规模量产的能力，通过技术突破和工艺革新，把原本高价的光学器件成本大幅优化。”

舜宇光学科技全力押注XR赛道，等待行业爆发拐点。尽管市场对AR眼镜等产品期待已久，但其“iPhone时刻”似乎仍未到来。王钺炯判断：“AR眼镜真正的放量可能要在2027年。”

与此同时，舜宇光学科技凭借靠谱的供应商形象，几乎覆盖了所有AI眼镜主流玩家。在技术路线上，公司看好衍射光波导方案作为未来主流，并在光学显示、信息接收、整机组装等环节全面卡位。公司还推出机器人数据采集相关视觉方案，抢占具身智能“视觉入口”。

“公司不会孤注一掷于单一技术路线，而是对每条技术路线都予以跟进，最终依据客户偏好来决策。”王钺炯说。

面对AI大模型带来的算力需求井喷，数据中心内部的光互连成为瓶颈。目前，CPO成为市场关注的新亮点，光电行业“追光而行”渐成趋势。“公司拥有大规模模组制造和封装的经验，同时与谷歌、微软等国际大客户建立了密切的合作关系。”王钺炯表示，面向未来，舜宇要向光通信、光计算乃至光存储这些前沿赛道延伸。

“我们将通过资本纽带，快速建立对新技术的认知和新业务的理解，而不是从头开始摸索。”王钺炯说。

据悉，舜宇光学科技正积极布局CPO上游领域，计划通过引进院士级CTO（首席技术官）强化技术方向把控，同时考虑用并购等方式加速在该赛道的落地进程。

高强度研发+差异化布局  
科创板生物制品企业  
锚定未来发展方向

◎记者 王墨璞

伴随行业竞争加剧、政策新规落地，生物制品行业正迎来技术迭代与政策红利的双重机遇。生物制品企业如何夯实研发壁垒，挖掘第二增长曲线，并把握产业转型机遇？

5月13日，“十五五·科创惠民”——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度生物制品行业集体业绩说明会召开。洁特生物、申联生物、诺唯赞、赛伦生物、康希诺、南模生物、特宝生物、华熙生物等18家上市公司高管齐聚，聚焦研发管线拓展、第二增长点挖掘、产业发展机遇和2026年发展规划等行业热点议题，回应广大投资者关切。

## 高投入筑牢壁垒 差异化竞争破局

从多家企业在业绩说明会上披露的情况来看，坚持高强度研发以筑牢主业根基、依托差异化战略开辟成长路径，已成为生物制品行业发展的核心方向。

“公司研发资源投入聚焦主业，2025年主要围绕关键底层技术迭代与突破、生命科学研究试剂产品升级与新品上市、神经领域疾病检测指标开发、核酸药物生产原料及微流控技术等方面展开。”诺唯赞董事长、总经理曹林表示。

据曹林介绍，公司持续加码技术研发，近三年平均研发投入占营收比例约为22.83%，处于同行业较高水平。截至2025年末，诺唯赞已有1200余种基因工程重组酶、5000余种高性能抗原和单克隆抗体、200余种其他功能性重组蛋白、150余种化学原料、70余种生化材料等关键原料，形成3000多个终端产品。

华熙生物2025年研发投入达4.72亿元，自2019年上市以来累计研发投入超过22亿元。“高研发投入使公司在行业内始终保持领先的技术壁垒与产品迭代能力。”华熙生物董事长兼总经理赵燕说。

2025年，华熙生物新增授权知识产权达624项，上市无菌级Hyatruce玻璃酸钠等13种生物活性原料新产品及创新解决方案，完成透明质酸水杨酸酯等4个化妆品新原料备案，并获批“润百颜·玻玻”“润致·凝透”2款三类医疗器械。

面对当前行业“头部效应显著、分化加剧”的竞争格局，差异化布局成为业内企业突围的关键。

面对业内竞争，南模生物董事长费俭表示，公司以基因编辑核心技术为底座，夯实科研客户基本盘，做强工业客户核心业务，依托“模型资源+CR0技术服务+数据服务”一体化能力构建全链条服务体系，同时通过上下游产业链投资打造第二增长曲线，在细分赛道持续构筑差异化竞争壁垒。

赛伦生物董事长范铁炯介绍，作为国内蛇伤特效药独家生产企业，公司现有产品覆盖抗蛇毒血清、抗狂犬病血清等核心品类。公司将坚持差异化研发，布局抗蜂毒血清、抗蜂毒血清、广谱抗蛇毒抗体、重组蛇毒血清、蛇毒快速检测诊断试剂等新产品，持续拓宽特色产品矩阵。

## 新规落地迎利好 明确年度发展目标

今年5月，《生物医学新技术临床研究和转化应用管理条例》等新规将施行，为中国细胞治疗产业带来转折点，也为生物制品企业带来发展机遇。在业绩说明会上，多家企业透露了细胞治疗领域的布局计划，还有企业明确2026年发展目标，力争推动业务实现高质量增长。

康希诺董事会主席、首席执行官兼总经理宇学峰表示：“康希诺将探索治疗领域产品，公司将根据不同的产品特性、竞争格局及未来价值前景，拥抱潜在的合作机会及各种可能性。”

洁特生物也在加码细胞治疗领域。公司于2025年11月在杭州设立全资子公司中赛柏泰，组建专业研发团队，重点开展面向细胞治疗应用领域的细胞培养整体解决方案、相关技术、设备及耗材的研发，抢占CGT（细胞与基因治疗）领域发展先机。

据洁特生物董事、总经理Yuan Ye James介绍，新规落地为公司带来多重利好，推动公司从传统实验室耗材龙头向生命科学高端耗材、高纯过滤材料双赛道平台型企业升级。具体而言，在工艺要求上，新规提高了行业合规准入门槛，行业正式进入规范化、高端化、头部集中化的发展阶段；在需求端，公司现有产品线完全匹配CGT产业链全流程需求，将直接受益于下游合规替换、增量扩容，打开CGT高端耗材百亿级成长空间。

面向2026年，各家生物制品企业锚定目标、细化规划，全力推进产品研发与市场落地。

申联生物董事会秘书於海霞透露，2026年计划取得4项兽药批准文号、上市4款新冠疫苗。同时，公司计划2026年推动2款创新药研发提速，预计三季度完成UB-221（抗过敏Anti-IgE单抗）针对慢性自发性荨麻疹适应症的内Ⅱ期临床试验报告，四季度启动Ⅲ期临床申请；UB-421（艾滋病治疗单抗）多重耐药适应症启动Ⅲ期临床申请。

宇学峰介绍，今年2月，公司的四价流感结合疫苗海欣适用人群扩大至3月龄至6周岁儿童，后续将推进7岁至59岁人群适用申请，实现流感预防全生命周期管理。

百克生物董事、总经理姜春称，2026年，公司将重点推进以下疫苗研发管线进展：加快推进液体鼻喷流感疫苗适用于18岁至59岁人群的Ⅲ期临床试验；推进百白破疫苗（三组分）Ⅲ期临床试验；准备开展狂犬单抗Ⅲ期临床试验；开展破伤风单抗Ⅲ期临床试验；完成冻干狂犬病疫苗（人二倍体细胞）Ⅰ期临床试验部分工作，开展Ⅲ期临床试验等。

先进封装叠加扩产持续  
半导体设备迎来“增量+替代”双重机遇

◎记者 李兴彩

近期以来，A股半导体设备板块持续走强，金海通、长川科技、拓荆科技等多家半导体设备公司股价创新高。

对此，有半导体业内人士在接受上海证券报记者采访时表示，AI及高性能计算等需求增长旺盛，给先进封装带来增量市场空间，叠加存储及逻辑芯片晶圆厂扩产，半导体设备公司迎来机遇大年，相关公司订单旺盛。

## AI算力推动先进封装 带来增量市场

“最近每个细分板块都表现不错。”金海通一名高管告诉记者，2025年以来，全球半导体行业延续增长态势，先进封装、AI及高性能计算等需求的增长，给半导体设备带来广阔的市场空间。

产业信息显示，由于AI对大算力芯片、HBM需求持续强劲，2.5D/3D先进封装产能持续紧缺，供不应求将延续至2027年下半年。机遇当前，国内半导体封测厂纷纷新建先进封装产能。

比如：通富微电定增预案显示，公司拟定增募不超过44亿元，用于存储芯片封测产能提升项目等；伟测科技拟发行不超过20亿元可转债，用于公司上海总部基地项目等；长电科技披露，公司2026年固定资产投资预算约100亿元，较往年预算大幅增长，将重点投向先进封装产线建设。

“今年是封装设备订单‘大年’。有半导

体业内人士告诉记者，晶圆厂、封测厂的投资，近八成都是设备支出，其大规模新建项目，意味着给半导体设备公司带来可观的增量市场空间、创新机遇。

紧抓市场机遇，半导体封测设备公司也在加快扩产步伐。

比如：盛美披露，公司临港A厂区满产状态下可达到100亿元的产值，预计B厂区今年下半年完成装修并投产，正式投产后可实现200亿元的年产值；金海通拟发行可转债募8.5亿元，用于上海澜博半导体设备制造中心建设项目、半导体先进装备技术研发项目等，可新增1200台/年高端测试分选机。

## “存储+逻辑”扩产 前道设备迎机遇

除了先进封装机遇，多家机构还看好扩产逻辑下的国产化机遇。

“半导体国产化，是我眼中当前性价比比较高、确定性较强的投资方向。”银华集成电路混合基金经理方建近日对媒体表示，当前国内存储、先进制程等正进入扩产大爆发阶段，龙头厂商扩产力度空前。

公开信息显示，随着存储芯片持续处于高景气周期，“两长”（长江存储、长鑫科技）正积极扩产，搭车行业高景气。与此同时，华虹公司、中芯国际等晶圆厂继续加快扩产。

长鑫科技在招股书（申报稿）中披露，公司拟募295亿元用于存储晶圆制造

量产线技术升级改造等项目。公司表示，本次发行上市能够有效加速公司产能规模的建设、工艺技术的升级、产品布局的完善和产品性能的优化，助力公司在全球DRAM市场占据更有利的地位。

公开信息显示，由于订单持续涌入，长江存储正以最快速度扩产，在今年建成一座新厂的基础上，还将再建两座工厂，全部投产后总产能将翻倍，有望达到月产10万片。

方建认为，高深宽比刻蚀、薄膜沉积等一批关键设备已实现国产突破，部分技术指标达到全球领先水平，相关企业有望受益于本轮扩产浪潮。

“两长”及晶圆厂的扩产，给半导体前道设备带来难得的验证及市场进入机遇。记者注意到，自2025年下半年以来，拓荆科技、中微公司、北方华创、华海清科等半导体前道设备公司纷纷开启扩产模式。

华海清科定增预案显示，公司拟定增募不超过40亿元，用于上海集成电路装备研发制造基地项目、高端半导体装备研发项目等。公司表示，当前营收主要由CMP设备贡献，募投项目的实施将有助于公司进一步提升离子注入装备的生产开发及市场拓展能力。

## 国产设备进入“创新”增长机遇期

值得关注的是，先进封装给半导体设备产业和公司带来“创新升级机遇”。记者了解到，先进封装所需的核心设备包括ALD（原子层沉积）设备、TSV（穿透硅通孔）

工艺设备、混合键合设备、ALE（原子层刻蚀机）设备、PECVD（等离子体增强化学气相沉积）等。

“旨在支持55纳米及以下高端IC工艺的后段金属互联工艺应用中的PECVD NDC（SiCN）工艺，应用场景包括铜氧化抑制、铜扩散阻挡层及刻蚀停止层。”提及盛美上海近期正式出机的等离子体增强化学气相沉积（PECVD）碳氮化硅（SiCN）设备，盛美上海CEO王坚告诉记者，盛美上海的PECVD SiCN设备基于自研的沉积架构设计（一个腔体三个工艺工位），以满足先进半导体制造中日益苛刻的工艺要求。

上海优睿半导体设备有限公司总经理唐德明在接受记者采访时表示，新的需求、新的应用场景不断涌现，中国半导体设备公司需要从复制拷贝走向“技术和应用创新”的发展阶段。

唐德明以优睿的FTIR设备为例介绍说，在FTIR设备领域，国产设备公司能“拷贝”的只有硅外延厚度测量和传统碳化硅外延厚度测量等应用方案。在当前的硼-磷-氟含量（B-P-F）、硅氢键（Si-H）、氮氢键（N-H）等元素浓度测量和化学键测量、晶棒氧元素含量测量等高端新应用场景中，国产设备没有现成方案可“拷贝”，只能创新算法和硬件研发去获取市场。

王坚表示，未来三年，盛美将投入50亿元研发资金，实现在涂胶显影、电镀等新赛道上的全面突破。“我们不仅要做好国产化，更要参与全球竞争。”